

轻松方便实现高精度切割晶片 手动划线笔



特长

- 防止划线时晶片移动
- 方便确认最佳划线位置
- 设定正确的切割点
- 保持最佳切割角度的设定
- 便于控制施加在晶片上的力度
- 轻松划直线，简单易用

使用方法

1 组装工具

2 在划线引导板上夹紧晶片

晶片

3 沿着引导槽切割

详情请扫描以下二维码
(1分钟即可生成视频)

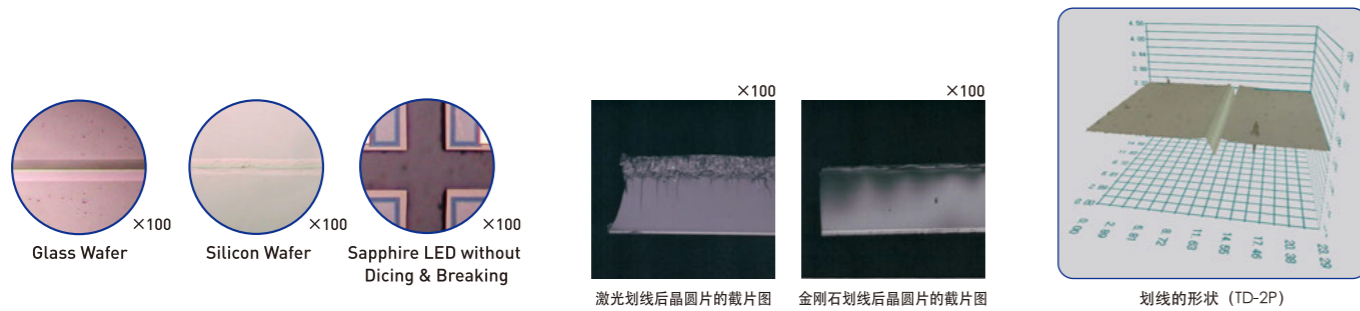
科钻金刚石划线刀



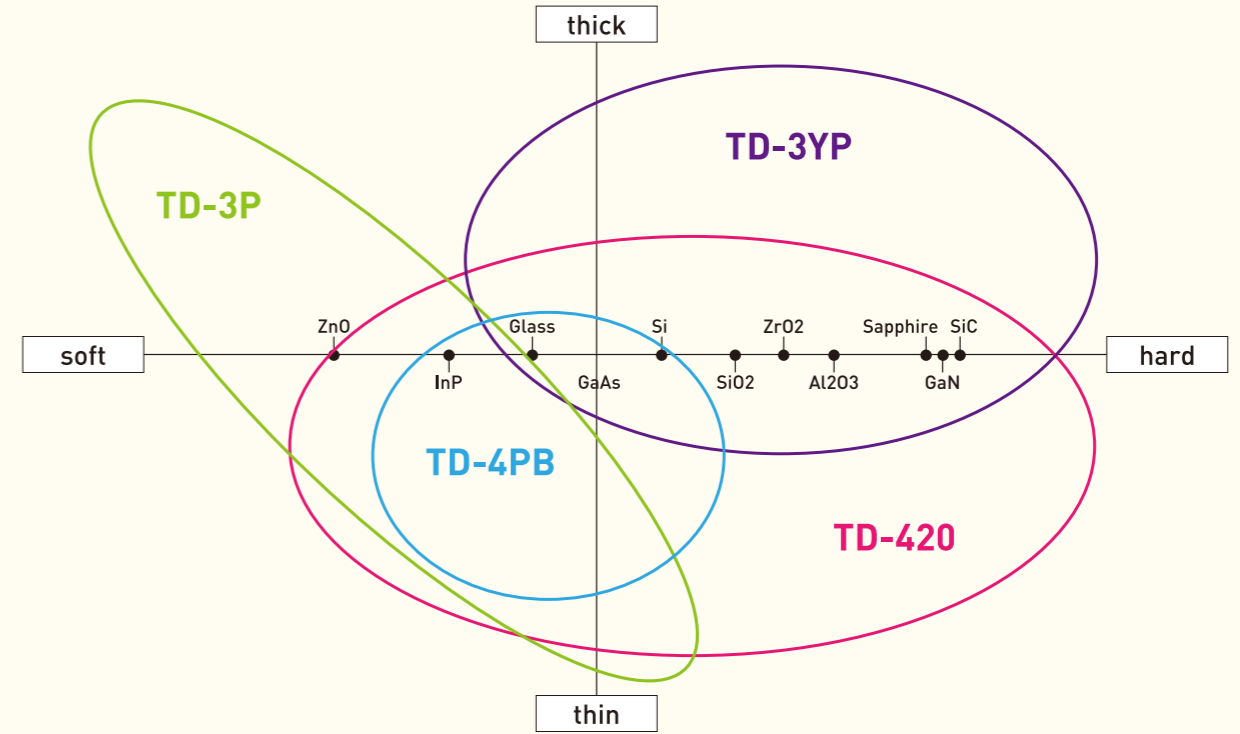
划线·专家 = 赶快体验一下科钻的划线产品。

金刚石划线刀的特点

- 1 干式划线**
因为换线作业时不用水，所以对水溶性材料或带静电等材料，不会由于水的因素对芯片造成不良影响
- 2 提高芯片的集成度**
通常使用划线工具切割的V形槽宽度为2~5μm，因此可提高每个晶片的芯片集成度，从而实现降低成本的计划。
- 3 控制裂纹**
所谓的金刚石划线，是利用划线时晶片内部所产生的应力原理，将晶粒切割成所需形状。如果想要将裂痕控制到得心应手，首先需要选择适合晶片的刀刃形状。

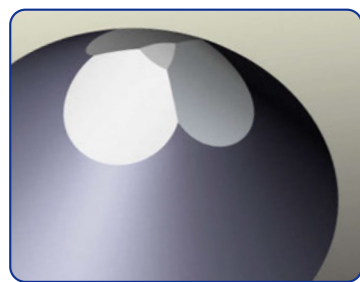


划线刀选择指南



*另TD-2P、TD-8P是定制品。
*上图的说明以外，应依照不同的晶圆片的表面制程(腐蚀、表面涂料等)，芯片尺寸(外观比例等)来选择金刚石划线刀。

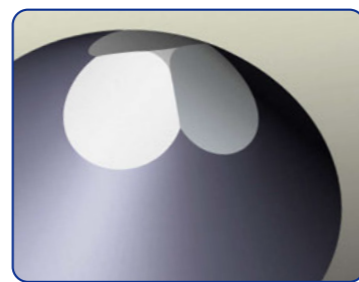
科钻之金刚石划线刀



TD-3YP

LED、SiC晶圆片划线刀

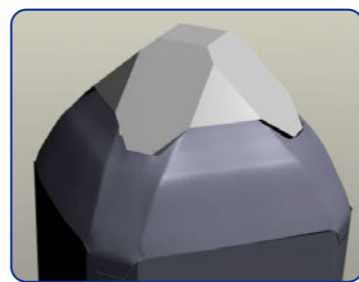
拥有三个切点的划线刀，由于划晶圆片时所接触点为钝角，因此适用于较厚的晶圆片，特别适用于LED蓝宝石晶圆片。



TD-3P

半导体晶圆片划线刀
(适用于InP等)

拥有三个切点的划线刀。TD-3YP不同之处在划晶圆片时所接触切点为锐角，因此适合在较硬的晶圆片上划出明显锐利的切线。



TD-4PB

半导体晶圆片划线刀
属于顶部划线型(适用于Si等)

拥有四个切点的划线刀。刀刃是利用钻石最坚硬的部分所制成。适用于GaAs, LCOS, Glass, Si等各种半导体晶圆片的划线。



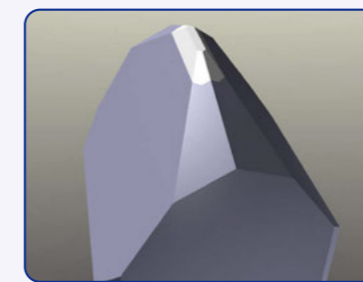
TD-420

半导体晶圆片划线刀
属于根部划线型(适于GaAs, Glass等)

拥有四个切点的划线刀。与晶圆片的切面为TD-4PB相反的三角形，相对与TD-4PB具有更细更深的切线和更强的内应力。(可以根据客户要求改变角度)

定制品

*可根据客户要求定制



TD-2P

半导体晶圆片划线刀
(顶部划线型)

与TD-4PB特点相同，但只有两个切点的划线刀。易于切入较深及较窄的切割道，适用于高低落差较大的晶圆片。



TD-8P

研发用划线刀
(顶部划线型/根部划线型)

结合TD-4PB和TD-420的刀刃，拥有8个切点的划线刀。推荐用于开发某种晶圆片的划线工艺条件时使用。